

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】令和5年3月1日(2023.3.1)

【国際公開番号】WO2021/256482

【出願番号】特願2022-531852(P2022-531852)

【国際特許分類】

B 4 4 C 1/17(2006.01)

B 4 1 M 5/00(2006.01)

B 3 2 B 7/06(2019.01)

B 3 2 B 27/20(2006.01)

10

【F I】

B 4 4 C 1/17 G

B 4 1 M 5/00 7 0 0

B 3 2 B 7/06

B 3 2 B 27/20 Z

【手続補正書】

【提出日】令和4年12月12日(2022.12.12)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

熱圧を加えることにより転写対象に転写されるホットスタンピング箔であって、  
第一面とその反対側に第二面を備えるキャリアと、  
前記キャリアの前記第一面に形成された積層光学構造体を含む積層光学装飾体と、  
前記キャリアの転写時に熱圧がかかる面である前記第二面に形成されたバックコート層  
と、を備え、  
前記バックコート層は、ホットスタンピング箔の熱転写温度よりも融点が高い芳香族化合物を含むバインダー樹脂と脂肪族化合物を主成分とした補助粒子との複合体であり、  
前記積層光学装飾体は、  
熱圧が加わった際の柔軟性が互いに異なる軟質樹脂と変形制限剤とを含有し、前記積層光学構造体上に形成された沈み込み制御層と、  
前記沈み込み制御層上に形成され、前記転写対象に接合される接着層と、を備え、  
前記接着層は、  
常温より低いガラス転移温度の熱可塑樹脂を含有する樹脂成分と、  
前記樹脂成分により形成された層の厚みよりも大きい粒径を有し、一部が前記樹脂成分から突出するスペーサー粒子と、を含有し、  
前記補助粒子が前記バインダー樹脂から突出する高さは、前記スペーサー粒子が前記樹脂成分から突出する突出高さより低く、  
前記バックコート層の表面は、動摩擦係数が0.30以下、かつ連続荷重式引掻き強度が9.5g以上である、  
ホットスタンピング箔。

30

40

【請求項2】

前記バックコート層の表面の静摩擦係数が0.35以上である、

請求項1に記載のホットスタンピング箔。

【請求項3】

50

前記バックコート層の前記バインダー樹脂は、前記接着層の融点またはガラス転移点よりも高い融点を有する、

請求項 1 または 2 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 4】

前記バックコート層の前記補助粒子は、前記接着層の融点またはガラス転移点よりも高い融点を有する界面活性剤を含有する、

請求項 3 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 5】

前記バックコート層における前記界面活性剤の比率が、固形分比で 1 % 以上 5 % 以下である、

請求項 4 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 6】

前記バックコート層の前記補助粒子は、前記接着層の融点またはガラス転移点よりも高い融点を有する樹脂ビーズである、

請求項 3 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 7】

前記バックコート層は、

酢酸セルロースまたはポリアミドイミドの前記バインダー樹脂と、

アマイドワックスを主成分とする前記補助粒子と、を含む、

請求項 1 から 5 いずれか 1 項に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 8】

前記補助粒子の平均粒径が 0.1  $\mu\text{m}$  以上 12  $\mu\text{m}$  以下である、

請求項 7 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 9】

前記バインダー樹脂に対する前記補助粒子の質量比が 1 % 以上 12 % 以下である、

請求項 7 または 8 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 10】

前記キャリアと前記バックコート層との間に設けられたアンカーコート層をさらに備える、

請求項 7 から 9 のいずれか一項に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 11】

前記バックコート層は、

酢酸セルロースまたはポリアミドイミドの前記バインダー樹脂と、

フッ素系樹脂を主成分とする前記補助粒子と、を含む、

請求項 1 から 3、および 6 のいずれか一項に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 12】

前記補助粒子の平均粒径が 0.1  $\mu\text{m}$  以上 12  $\mu\text{m}$  以下である、

請求項 11 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 13】

前記バインダー樹脂に対する前記補助粒子の質量比が 1 % 以上 12 % 以下である、

請求項 11 または請求項 12 に記載のホットスタンピング箔。

【請求項 14】

前記キャリアと前記バックコート層との間に設けられたアンカーコート層をさらに備える、

請求項 11 から 13 のいずれか一項に記載のホットスタンピング箔。

10

20

30

40

50